



李長榮科技股份有限公司
LCY TECHNOLOGY CORP.

2019/12

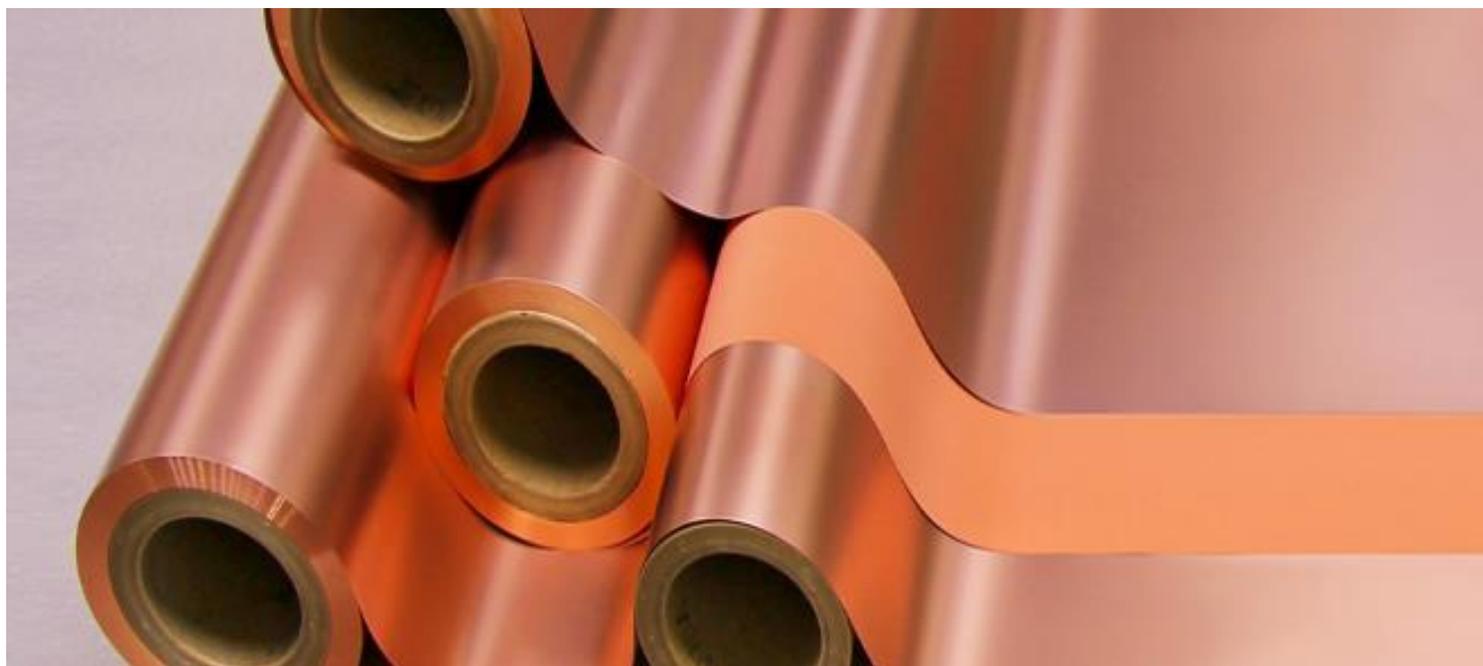
Differentiation · Innovation · Green

免責聲明

- 本簡報合併財報數字係根據國際財務報導準則編製，並經由會計師核閱。
- 本簡報中可能包含對產業及前景之預測，係基於對現況之預期，但可能同時受限於已知或未知風險與不確定性影響。因此實際結果將可能明顯不同於所陳述之內容。
- 除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。
- 本簡報資料不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約或要約之引誘。
- 本簡報資料之著作權歸本公司及本公司關係企業所有，不得直接或間接複製或傳送給任何第三人，且不得為任何目的出版刊印。

大綱

1. 公司簡介
2. 產業概況
3. 產品及市場
4. 營運績效
5. 經營理念及未來展望
6. Q & A



公司簡介

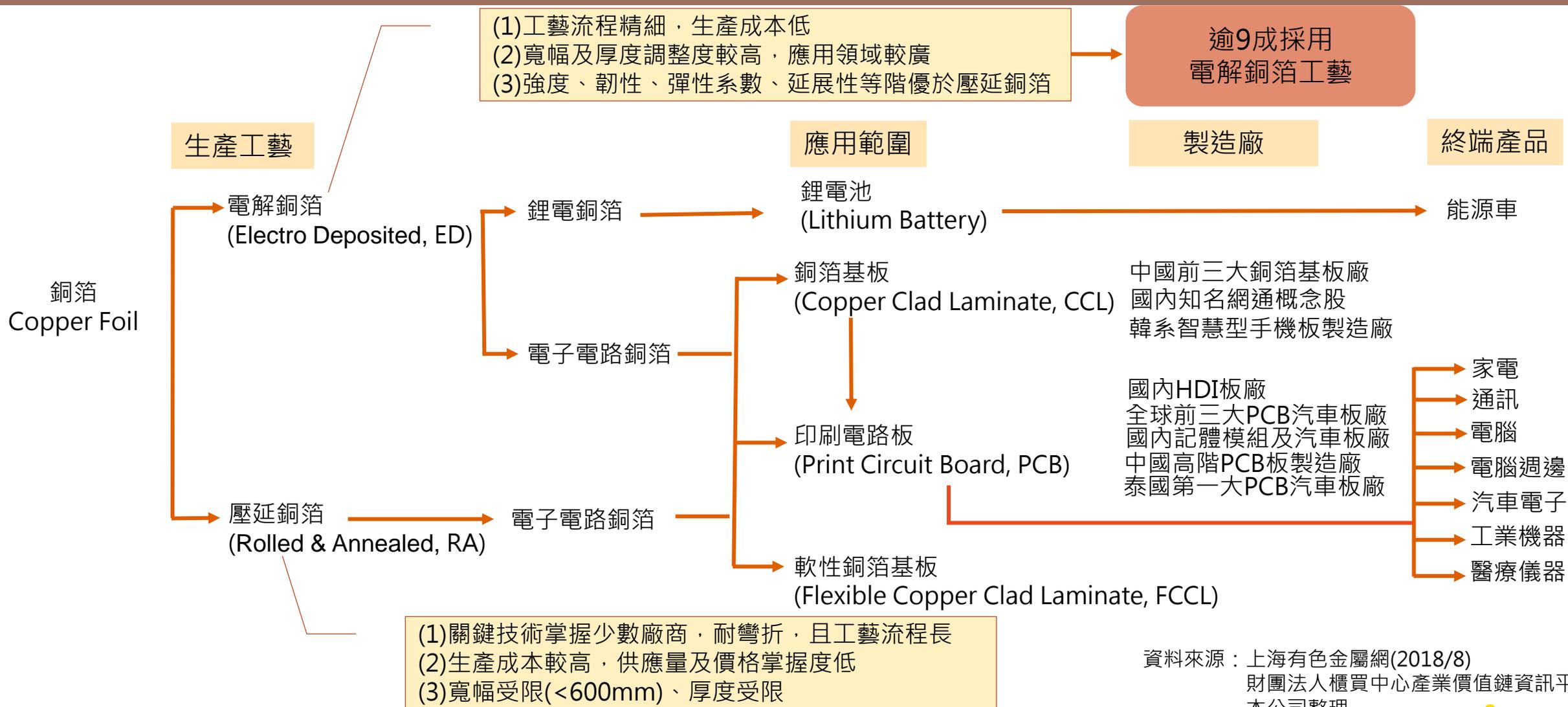
基本資料

- 成立日期：1997年1月16日
- 董事長兼執行長：王守仁
- 總經理：陳銘樹
- 股票上市掛牌日：2018年6月28日
- 實收資本額：新台幣1,530,850仟元
- 營業項目：電解銅箔之設計、製造及銷售

公司沿革

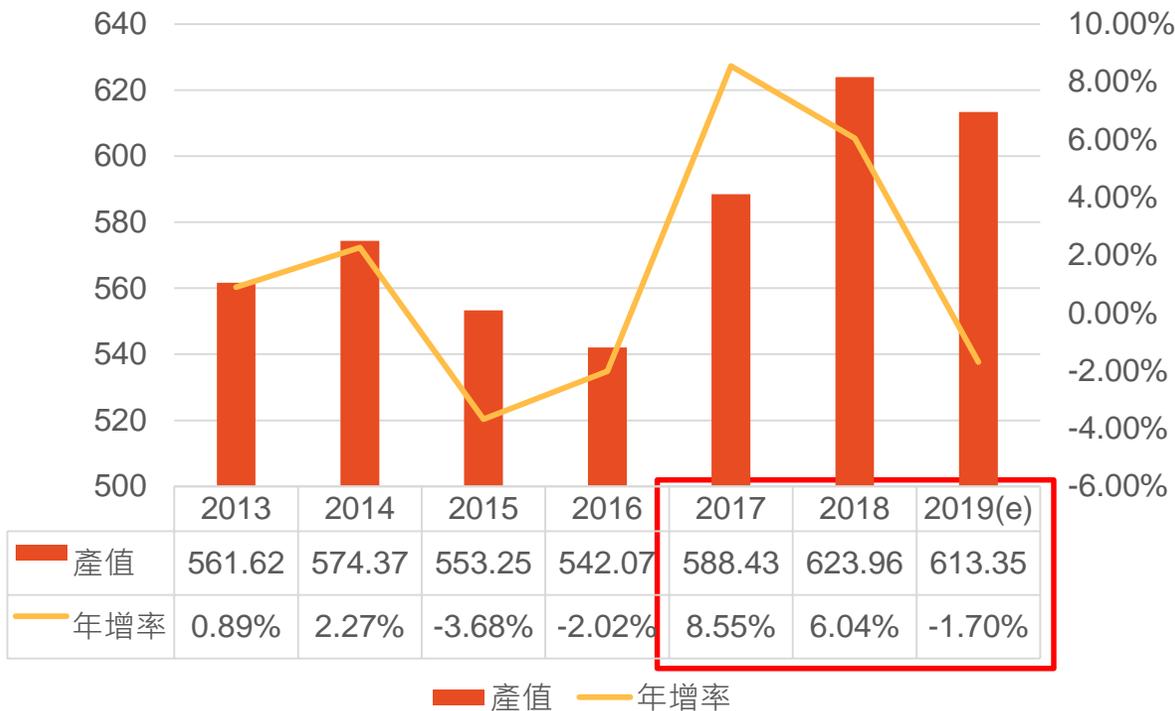
- 2019 VLP產線(ED#30)預計將於年底前完工
- 2018 KKR收購母公司榮化，榮科成為KKR間接持股之關係企業
股票掛牌上市，資本額 NT 1,530,850仟元
擴建VLP產線(ED#30)動工
- 2017 股票公開發行暨登錄興櫃
- 2007 工廠擴建完工，年產量：10000噸
- 2000 工廠完工試車，年產量：5000噸
- 1997 李長榮科技股份有限公司成立，資本額 NT 200,000仟元

產業概況



產品及市場

全球PCB產值 單位：億美元

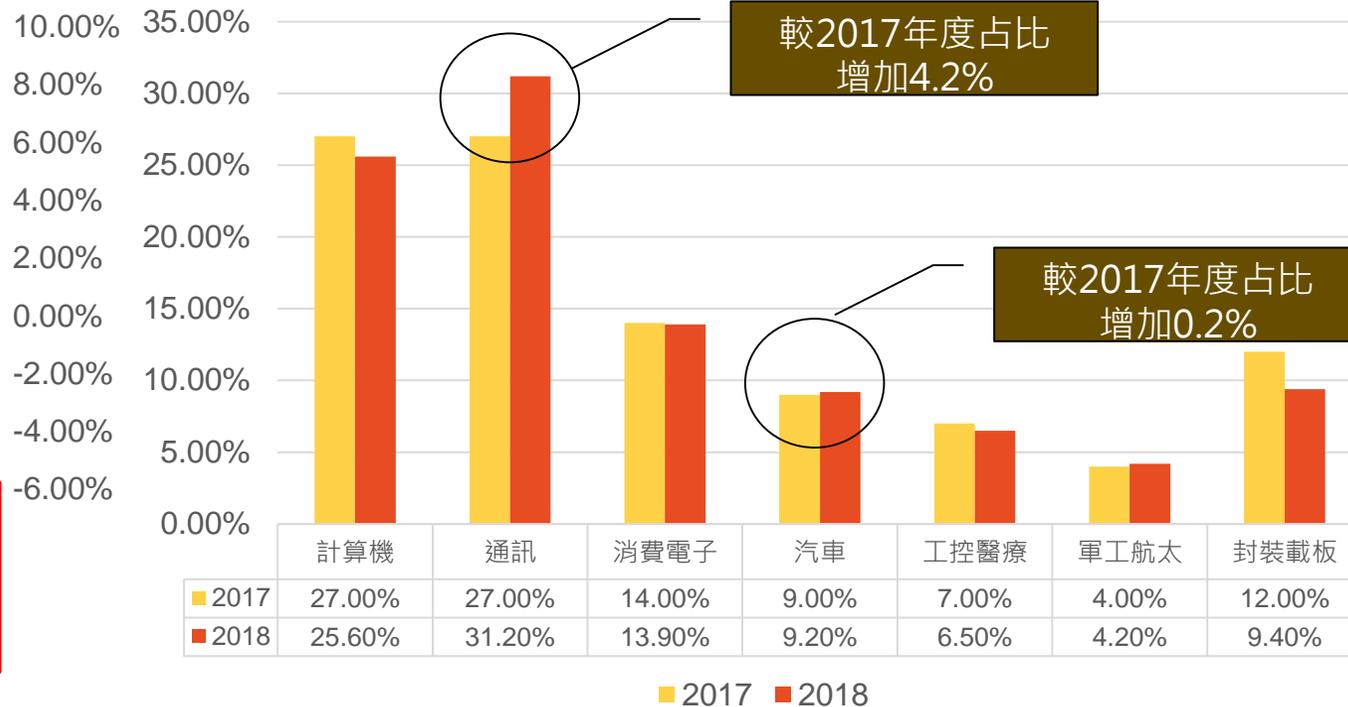


2017年度：
汽車電子、消費電子、通訊設備開創PCB產業的新週期

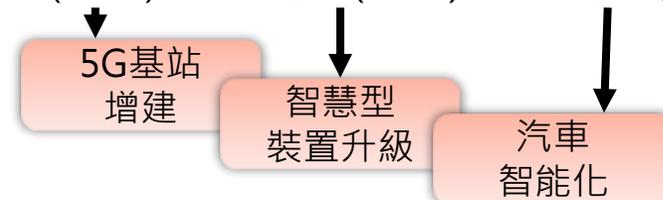
2018年度：
5G 世代、智慧手機升級、互聯網興起，及汽車電子複雜度的提升

2019年度：
網通、基地台需求升溫，但智慧型手機需求疲弱+美中貿易不確定性

PCB 下游應用領域占比變化



研究機構預測：2018 年~2022 年下游應用領域對 PCB CAGR 的貢獻將主要集中在 **通訊 (3.5%)**、**消費電子 (4.2%)**、**汽車電子 (3.9%)**

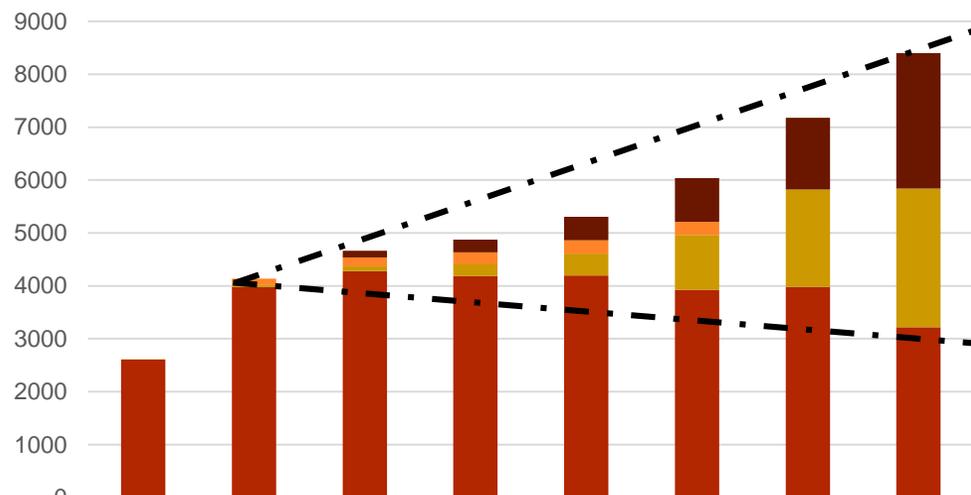


產品及市場

需求

5G網通基礎建設

全球新建/升級之小型基地台市場趨勢 單位：千台



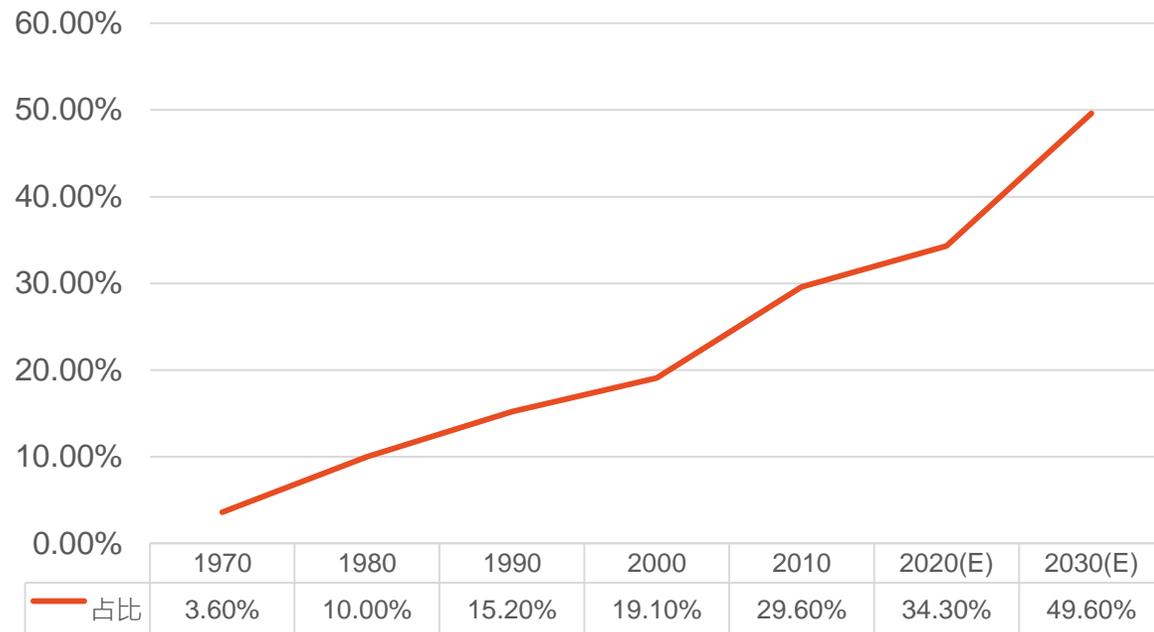
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5G NR standalone	0	0	125	241	443	829	1353	2562
5G NR Non-Standalone	0	118	167	227	249	245	0	0
5G/4G combined BTS	2	34	92	222	416	1035	1843	2621
LTE or 3G/4G	2604	3982	4279	4185	4197	3928	3982	3220

■ LTE or 3G/4G ■ 5G/4G combined BTS ■ 5G NR Non-Standalone ■ 5G NR standalone

資料來源：SCF、資策會MIC，2019/7

車載電子+動力及安全系統

汽車電子占整車成本比重



受惠於5G的高速傳輸速率，低延時特性，加速車聯網及自動駕駛，未來汽車電子化程度將大大提升

資料來源：Prismark、中國產業信息網，2019/8

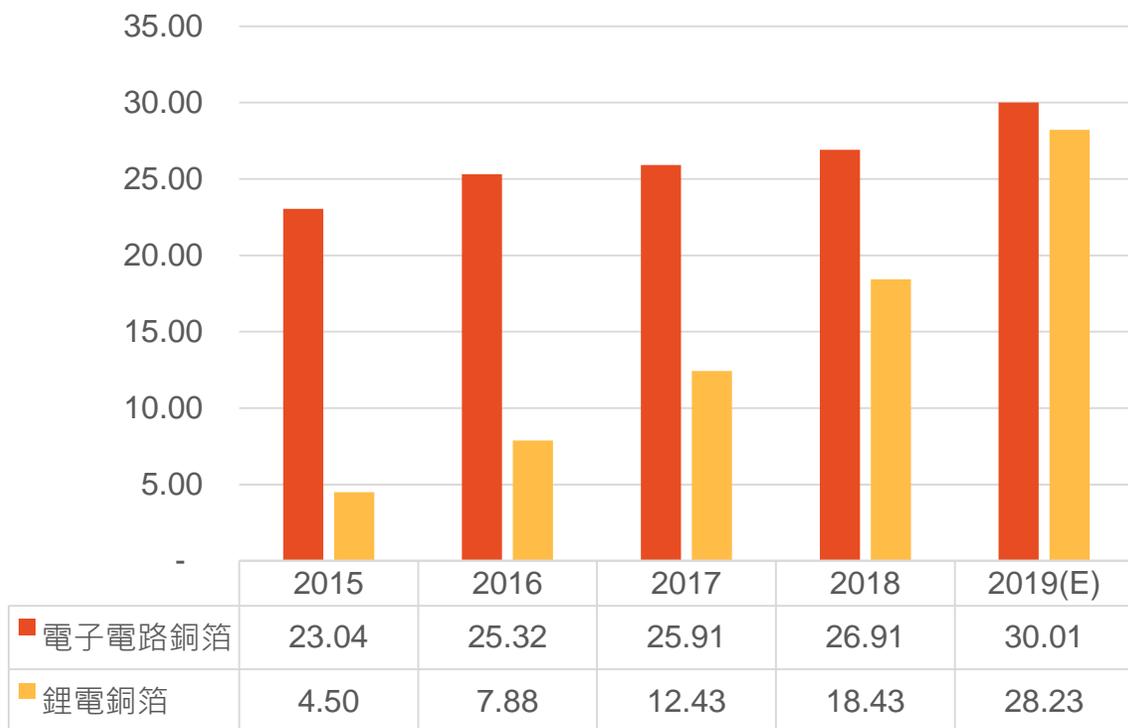
產品及市場

供給

電解銅箔產能

銅箔產能

單位：萬噸



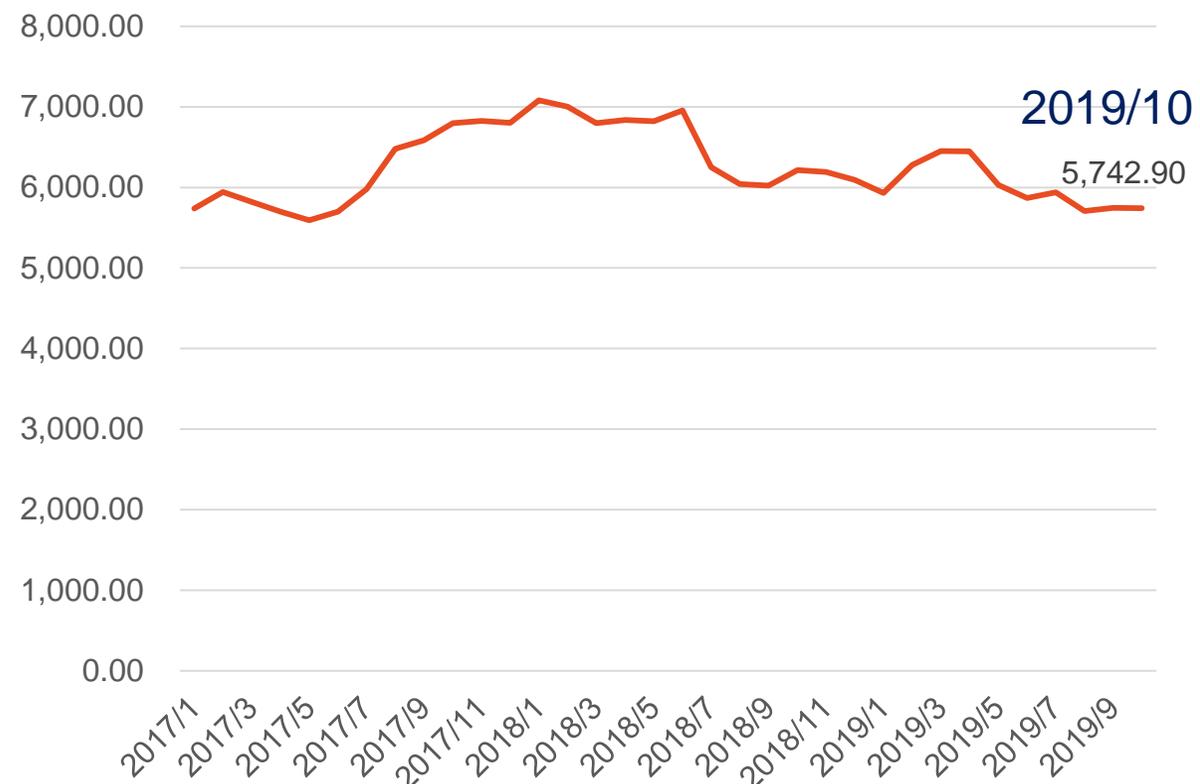
■ 電子電路銅箔 ■ 鋰電銅箔

資料來源：TPCA協會

LME銅價走勢

LME銅價走勢

單位：美元



資料來源：臺灣區電線電纜工業同業公會、本公司整理



產品及市場

應用領域	電子電路銅箔項目
5G通訊、汽車電子	高頻高速電解銅箔
半導體封裝載板	9μm以下附載體銅箔
大功率、大電流 汽車厚銅基板	厚銅箔 (2oz~6oz)
手機	二層法電解銅箔
HDI多層板	HDI用電解銅箔

主要產品

PK-HTE-LP3

主要特色	產品應用
符合IPC-4562A Grade 3之毛面瘤化處理箔	可用於一般Tg、Hi-Tg、無鹵基板等基材，單面、雙面、多層板均可用
毛面經粉紅色抗熱層處理	

PK-HTE-RTF

主要特色	產品應用
符合IPC-4562A Grade 3之反轉瘤化處理箔	高頻產品 內層薄板
均一瘤化鍍層處理，膠片結合粗糙度較一般箔低	

BR-DSS-LX series

主要特色	產品應用
極低粗糙度的紅棕色箔	高頻產品 極細線路板
均一的次微瘤化鍍層處理	

產銷狀況

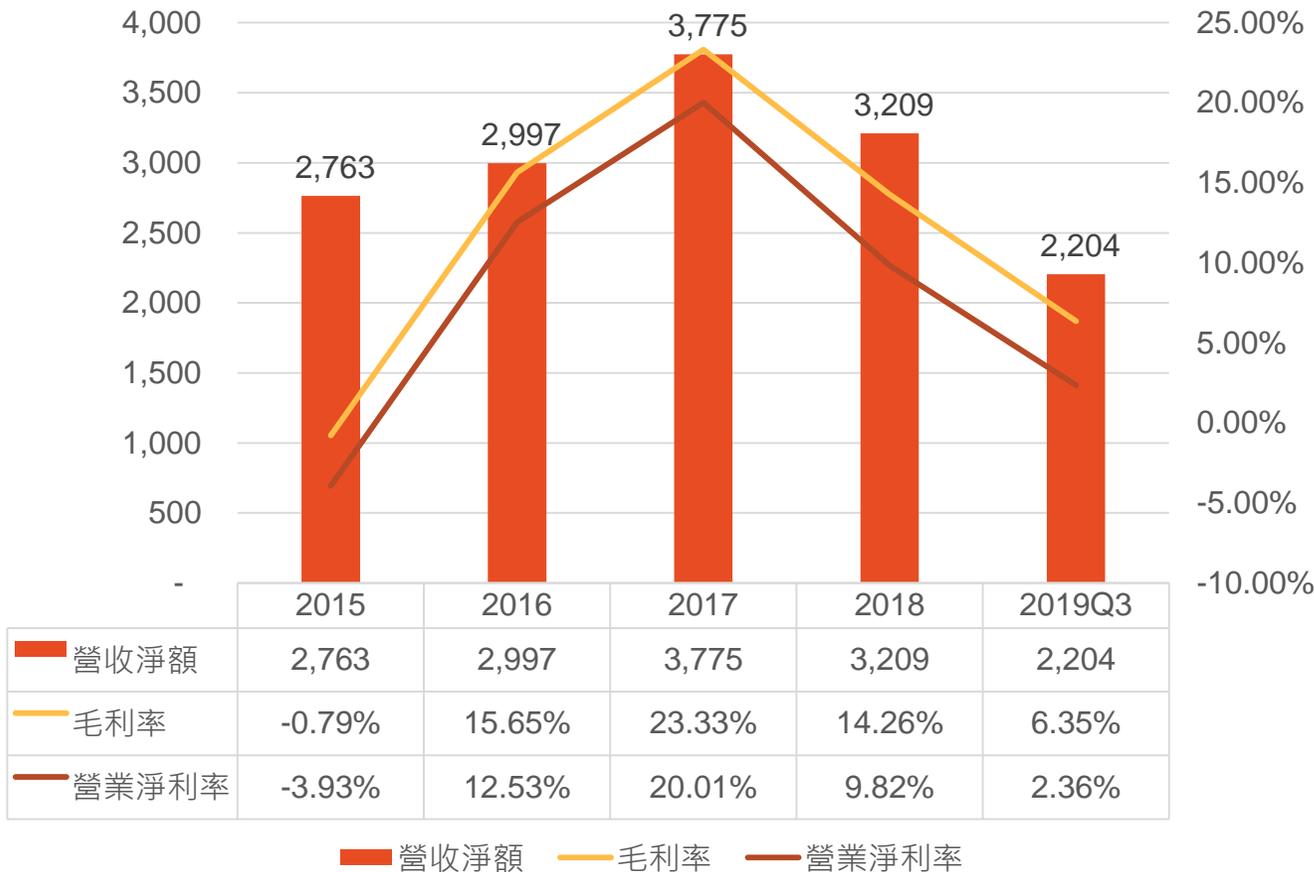


資料來源：電子銅箔資訊第41期，2018/8

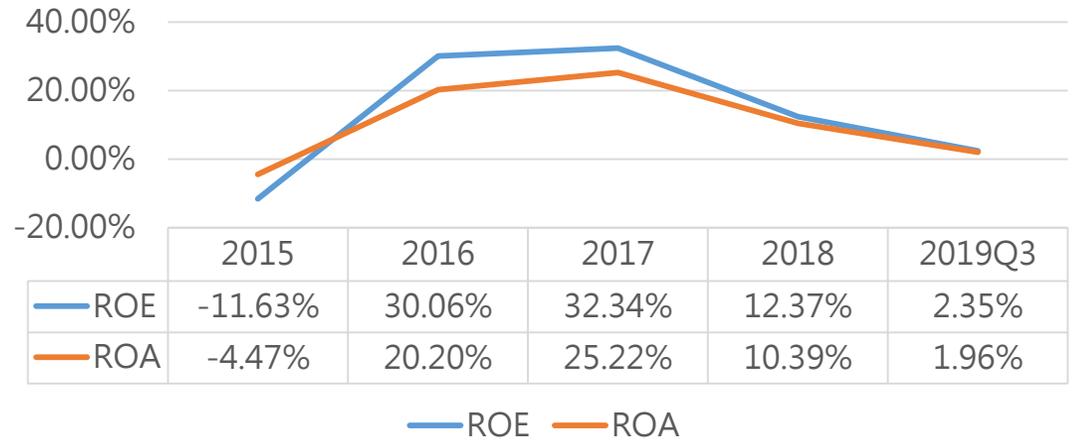
營運績效

單位：新台幣百萬元

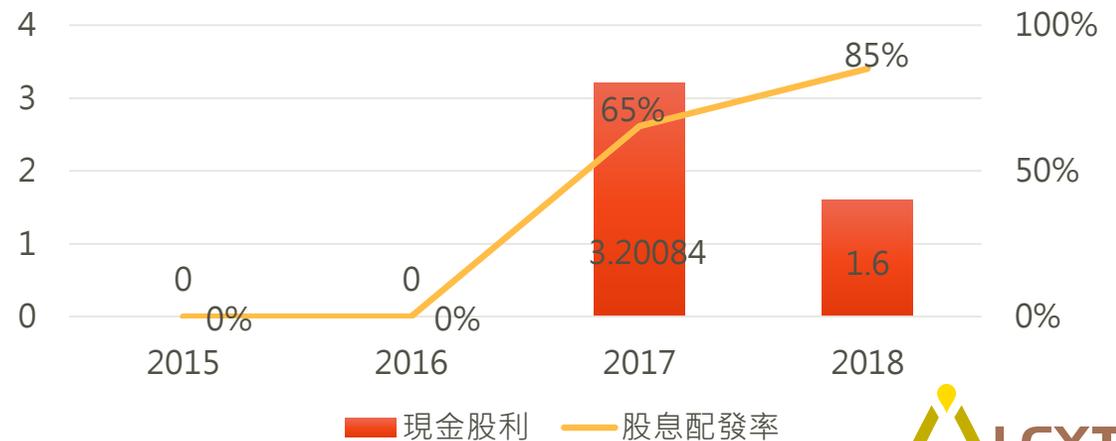
營收及獲利能力



ROE/ROA



歷年股利發放金額及發放比率



經營理念及未來展望



研發端

因應終端數據需求市場：
(1)CCL：增加抗撕強度
(2)PCB：低介電常數(Low Dk)
低介電損失(Low Df)

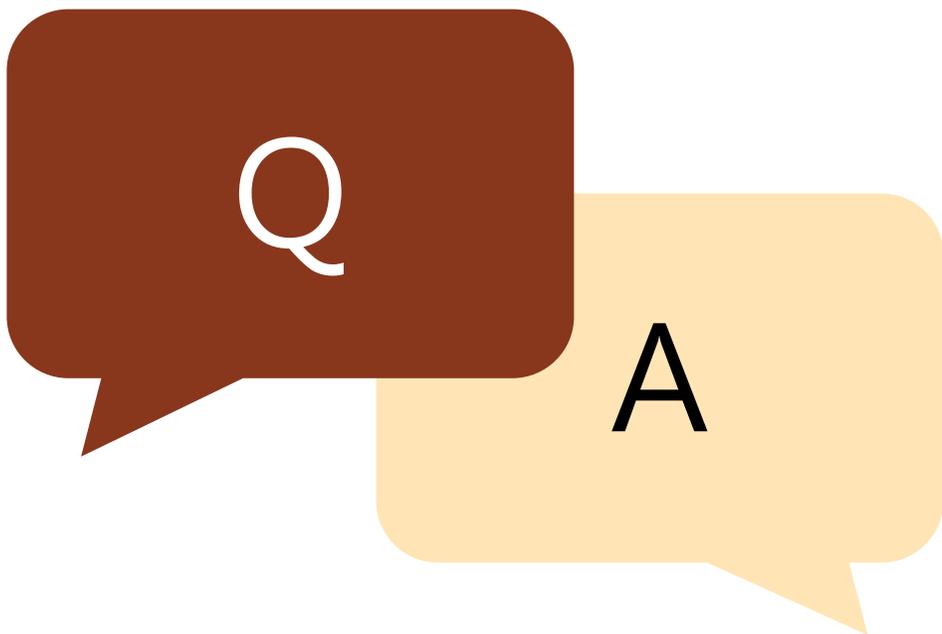
業務端

(1)特殊板卡用箔客戶來廠稽核完成
(2)銷售版圖分散：中(70%)、泰(9%)、
台(12%)、歐(1%)

生產端

產線調度，持續放量：
(1)高穩定度、(2)高附加價值
(3)利基性產品

Q & A



- 發言人：陳銘樹，Paul Chen
- 代理發言人：蔡孟修，Berry Tsai
- 聯絡電話：(02)2763-1611
- 聯絡信箱：lcyt@lcygroup.com
- 公司資訊：www.lcyt.com.tw



Thanks for your attention!

Differentiation · **I**nnovation · **G**reen